

珠海市半导体行业协会

珠半协秘〔2026〕15号

关于组团参加 2026 第 26 届中国国际工业博览会的通知

各有关企业：

中国国际工业博览会（CIIF）是经国务院批准，由工业和信息化部、商务部、中国科学院、中国国际贸易促进委员会等共同主办的国家级、国际性工业品牌展会，是中国工业领域面向世界的重要窗口和经贸交流合作平台。根据珠海市高新区国家外贸转型升级基地（集成电路）工作站的参展安排，现组织企业组团赴上海参加 2026 年第 26 届中国国际工业博览会，诚挚邀请各相关企业参加本次珠海展团。现将有关事项通知如下：

一、展会情况

展会时间：2026 年 10 月 12 日-16 日

展会地点：国家会展中心（上海）

二、展会亮点

中国国际工业博览会（简称“中国工博会”或“工博会”）是我国以中国冠名的、历史最长的国家级工业展会，自 1999 年

创办以来，已成功举办二十余届。是国内展览规模最大、参展企业最多、展示领域最广、国际化程度最高的工业展会之一。

2026 年，本届工博会设立数控机床与金属加工展、工业自动化展、机器人展、智慧能源展、信息与通信展、智行未来展、绿色低碳展、新材料产业展、科技创新展、集成电路展（国芯展）十大主题展区，赋能制造全产业链。展览总面积超 30 万平方米，邀请超过 3000 余家企业参会，20 余万专业人士汇聚现场，整合全域资源，绽放品牌光芒。工博会集“展示、交易、评奖、论坛”四大功能于一体，面向国际展示中国工业高质量发展成果，促进中国工业与全世界的交流、交往和交融。

三、展品范围

1. 处理器与计算芯片（CPU、GPU、NPU、MCU、DPU、TPU、通用/车规/AI 等各类 SoC）、存储芯片、电源管理芯片和功率半导体、模组、其他专用芯片（FPGA、传感器、射频与通信芯片、光电芯片）、EDA 工具与平台、IP 核与设计服务等；；

2. 先进逻辑与特色工艺平台、IDM 与存储器制造、化合物半导体制造、厂务设施及智能制造解决方案；

3. 先进封装服务(AI 算力芯片封装、汽车电子封装、晶圆级封装、系统级封装等)、封装测试设备与制程、下一代基板与工艺（玻璃基板等）、封装材料；

4. 晶圆制造核心设备（光刻、刻蚀、薄膜沉积、清洗、CMP

等)、量测、检测与过程控制装备、化合物半导体专用设备(外延生长设备等)、半导体关键材料(硅片、衬底、光刻胶、电子特气等)、关键子系统与核心零部件(真空系统、射频电源、精密部件等);

5. AI 新基建、具身智能、智能汽车-汽车行业国家上下游企业; 消费电子产品, 如智能家电、智能电子穿戴设备等

四、珠海展团情况

本届中国国际工业博览会协会将组团参加。珠海展团将设立 36 m²特装展位(展位号: 6.2-A073), 以珠海整体形象参展, 突出推介珠海基地内优秀企业和产品。展位面向珠海基地半导体和集成电路企业, 符合条件的企业可入驻珠海公共展位。

五、报名办法

请有意向参展及采购的企业于 2026 年 9 月 12 日 17:00 前填写附件表格以邮件形式发送至协会邮箱: member@zhsia.org.cn。

(注: 名额有限, 先到先得。请有兴趣的企业抓紧时间报名)

联系人: 金子杨, 13726259646

附件: 1.境内(外)展会参展报名表(合同书)

2.参展企业及展品信息征集表

3.参展人员信息登记表



工博会简介

中国国际工业博览会（简称“中国工博会”或“工博会”）是我国以中国冠名的、历史最长的国家级工业展会，自 1999 年创办以来，已成功举办二十余届。工博会覆盖从制造业基础材料、关键零部件，到先进制造装备、整体解决方案的智能绿色制造全产业链，是国内展览规模最大、参展企业最多、展示领域最广、国际化程度最高的工业展会之一。

2025 年工博会展览总面积 299020 m²，来自 27 个国家和地区 3011 家企业（参展商）参展，大会发布代表性成果 400 余项。大会观众来自 133 个国家和地区 186290 人次，观展目的明确。其中技术交流、收集了解市场信息占比 64.61%；采购产品或寻求技术占比 49.50%，寻求代理经销占比 16.15%等。

2026 年，本届工博会设立数控机床与金属加工展、工业自动化展、机器人展、智慧能源展、信息与通信展、智行未来展、绿色低碳展、新材料产业展、科技创新展、集成电路展（国芯展）十大主题展区，赋能制造全产业链。展览总面积超 30 万平方米，邀请超过 3000 余家企业参会，20 余万专业人士汇聚现场，整合全域资源，绽放品牌光芒。工博会集“展示、交易、评奖、论坛”四大功能于一体，面向国际展示中国工业高质量发展成果，促进中国工业与全世界的交流、交往和交融。